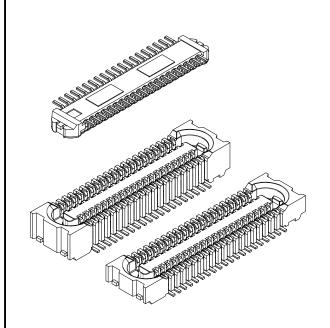


KGN CONNECTOR

0.35mmピッチ/プリント基板用/基板対基板接続用



0.35mm ピッチ、嵌合高さ 1.0mm と 1.5mm、 製品幅 2.88mm の基板対基板 (FPC) 接続用 コネクタ

■特徴

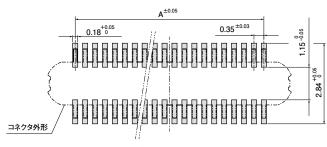
- 高い保持力を確保したコンタクトロック機構
- 接触信頼性の高い 2 点接点構造
- コンタクト底部の配線スペース確保 (パターン禁止エリア無し)
- 0.5A/pin に対応可能
- •挟み込み端子構造による明確なクリック感

■一般仕様

- 定格電流: 0.5A AC/DC
- 定格電圧: 30V AC/DC
- 使用温度範囲: -25℃~ +105℃ (通電時の温度上昇値を含む)
- •接触抵抗:初 期 / 50mΩ以下 耐候性試験後/80mΩ以下
- 絶縁抵抗: 100MΩ 以上
- 耐電圧: AC100V を1分間印加にて絶縁破壊なきこと
- ※ご使用に際しては、弊社ウェブサイト(製品情報ページの技術 資料末項) に記載のご使用上の注意事項を参照ください。
- ※RoHS2対応品を掲載しています。
- ※寸法の単位には mm を採用しています。
- ※詳細は弊社までお問い合わせください。

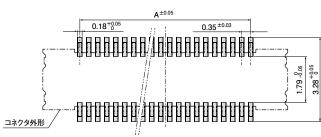
基板レイアウト

プラグ



推奨基板レイアウト

リセプタクル



推奨基板レイアウト

•メタルマスク厚 100~120µm

0.18 +0.05

•メタルマスク厚 100~120µm

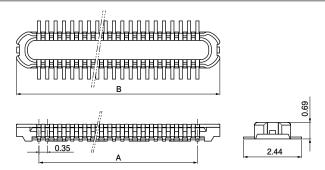
0.18 +0.05 $0.35^{\pm0.03}$ +0.05 2.84 1.66

推奨メタルマスクレイアウト

- 注1) 基板レイアウトはコネクタ装着側から見た図です。 2) 基板パターンピッチの公差は±0.03で累積しないこと。 3) N2リフローの場合は実装確認の上、ご使用ください。

 $0.35^{\,\pm0.03}$

プラグ

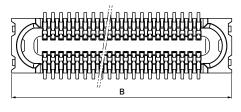


極数	形 番	寸 法 (mm)		個数/リール	材 料・表面処理等
	/I2 H	Α	В	一段 ファン	
30	30P-JKGNK-GAN-ETF(HF)	4.90	6.78	9,000	-> 4 5 I . AB A A . DO A A . X
40	40P-JKGNK-GAN-ETF(HF)	6.65	8.53	9,000	コンタクト:銅合金、部分金めっき
60	60P-JKGNK-GAN-ETF(HF)	10.15	12.03	9,000	ハウジング:LCP
70	70P-JKGNK-GAN-ETF(HF)	11.90	13.78	9,000	その他:銅合金
90	90P-JKGNK-GAN-ETF(HF)	15.40	17.28	9,000	

本製品はエンボステーピング供給品です。

リセプタクル

嵌合高さ 1.0mm 用

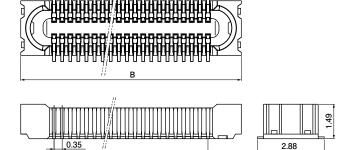




極数	形 番	寸 法 (mm)		- 個数/リール	材 料・表面処理等
		Α	В	四数/ ツ ル	
40	40R1.0 - JKGNK - GAN - ETF (HF)	6.65	9.53	7,400	コンタクト:銅合金、部分金めっき
60	60R1.0 - JKGNK - GAN - ETF (HF)	10.15	13.03	7,400	ハウジング:LCP
90	90R1.0 - JKGNK - GAN - ETF (HF)	15.40	18.28	7,400	その他 : 銅合金

本製品はエンボステーピング供給品です。

嵌合高さ 1.5mm 用



極数	形番	寸 法 (mm)		個数/リール	材 料・表面処理等
	/I2 H	Α	В	四数/・フ ル	
30	30R1.5 - JKGNK - GAN - ETF(HF)	4.90	7.78	6,000	
40	40R1.5 - JKGNK - GAN - ETF (HF)	6.65	9.53	6,000	コンタクト:銅合金、部分金めっき
60	60R1.5 - JKGNK - GAN - ETF (HF)	10.15	13.03	6,000	ハウジング:LCP
70	70R1.5 - JKGNK - GAN - ETF (HF)	11.90	14.78	6,000	その他・・銅合金
90	90R1.5 - JKGNK - GAN - ETF (HF)	15.40	18.28	6,000	

本製品はエンボステーピング供給品です。